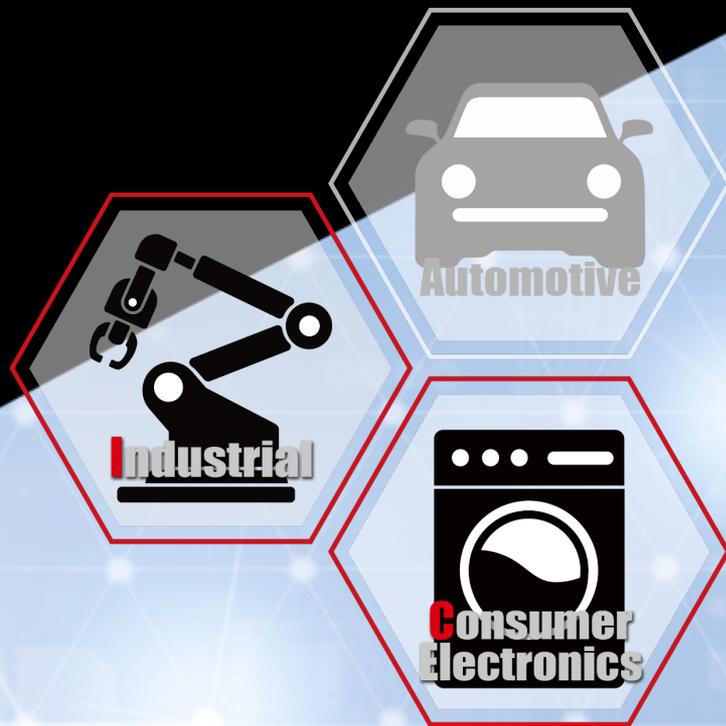


非常适用于通信基站和工业设备等的风扇电机驱动

实现业界超低导通电阻的 100V耐压双MOSFET

HP8KEx/HT8KEx系列、
HP8ME5



HP8KEx/HT8KEx系列和HP8ME5是实现了小型化和出色散热性能的双MOSFET产品。

与以往的双MOSFET相比，其导通电阻显著降低，非常有助于应用设备更加节能和减少安装面积。

Features

- 实现业界超低导通电阻，有助于设备更节能
- 将两枚器件一体化封装（双MOSFET），体积更小
有助于减少安装面积和设计工时
- 与ROHM的电机驱动器IC组合使用，可实现更出色的电机驱动解决方案

小型、散热性能出色的双器件一体化封装

HSOP8 (双)



5.0×6.0×1.0mm

HSMT8 (双)

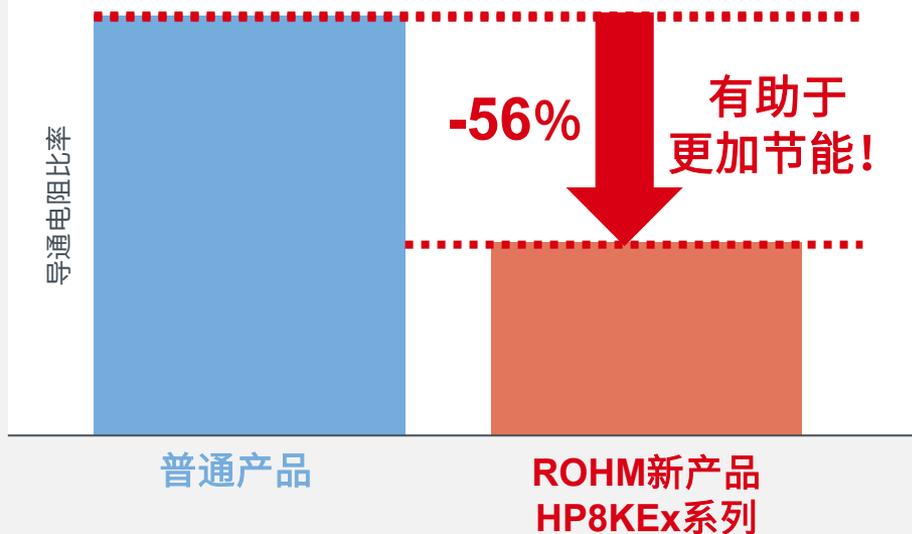


3.3×3.3×0.8mm

实现业界超低导通电阻

<条件>

使用HSOP封装的双MOSFET。设普通产品=100，在 $V_{GS}=10V$ 条件下进行比较



采用ROHM最新的微细工艺和散热性能出色的封装形式，与普通产品相比，导通电阻降低达**56%**

面积比较：双MOSFET (Nch+Nch) 以往产品与新产品

用新产品取代以往产品，可以显著减少安装面积

例1 将2枚单MOSFET替换为新产品时

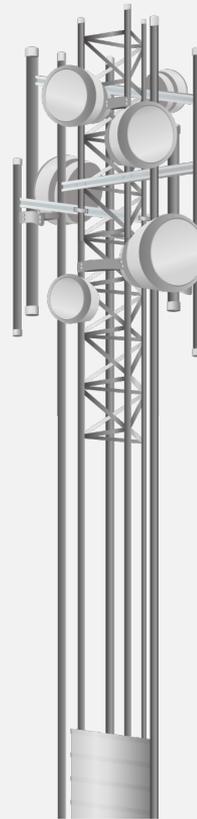
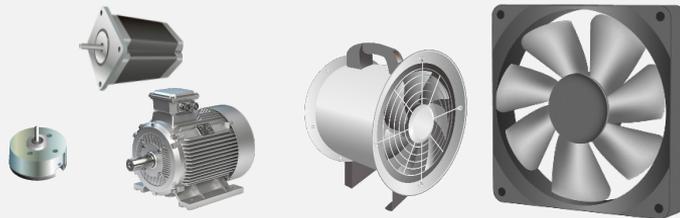


例2 将以往双MOSFET替换为新产品时



有助于减少安装面积和设计工时

- 通信基站中继器、数据服务器、FA设备等工业设备用的风扇电机
- 大型消费电子产品用的风扇电机

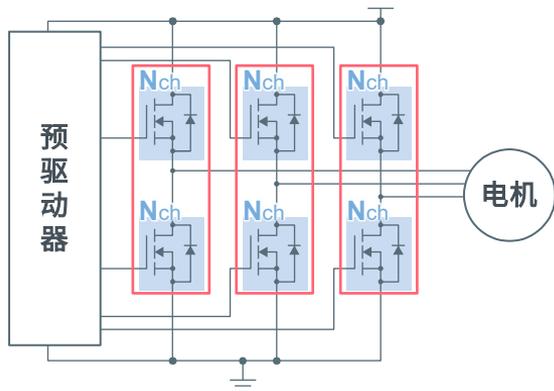


100V耐压 低导通电阻 Nch+Nch/Nch+Pch 双MOSFET 产品阵容

产品名称	极性 [ch]	V _{DSS} [V]	I _D [A] T _C =25°C	P _D [W] T _C =25°C	R _{DS(ON)} [mΩ]				封装 [mm]
					V _{GS} =10V		V _{GS} =4.5V		
					Typ	Max	Typ	Max	
New HP8KE6  	N+N	100	17	21	41	54	53	73	HSOP8 5.0×6.0×1.0 
New HP8KE7  			24	26	15.1	19.6	18.6	27.8	
New HT8KE5  	N+N	100	7	13	148	193	200	300	HSMT8 3.3×3.3×0.8 
New HT8KE6  			13	14	44	57	56	83	
New HP8ME5  	N+P	100	8.5	20	148	193	200	300	HSOP8 5.0×6.0×1.0 
		-100	-8.0		210	273	233	303	

点击  图标即可链接到ROHM官网的产品介绍页面，点击  图标即可链接到ROHM官网的产品技术规格书。

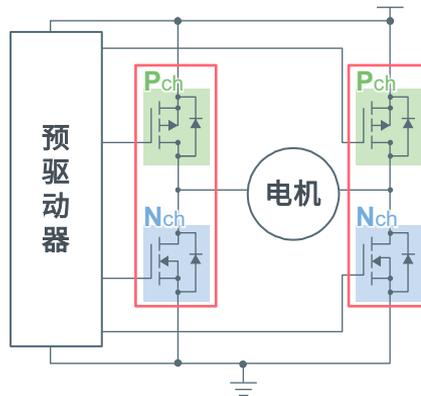
三相无刷电机电路



使用2X3个Nch MOSFET

⇒ 用3枚双MOSFET (Nch+Nch) 即可
(由Nch + Nch MOSFET驱动)

单相无刷电机电路



使用多个Nch · Pch MOSFET

⇒ 如果使用双MOSFET (Nch+Pch) ,
设计时只需单MOSFET数量的一半即可
(由Nch + Pch MOSFET驱动)

电机驱动器 详细信息

(ROHM官网)

三相无刷电机驱动用
预驱动器IC

[三相无刷电机驱动器_产品搜索结果_罗姆半导体集团\(ROHM Semiconductor\)](#)

单相无刷电机驱动用
预驱动器IC

[单相直流无刷电机驱动器_产品搜索结果_罗姆半导体集团\(ROHM Semiconductor\)](#)

**与ROHM的电机驱动用预驱动器IC组合使用，
可轻松实现电机PCB板的小型化、更低功耗以及静音驱动**

Notice

- 本资料中的内容旨在介绍ROHM集团（以下简称“ROHM”）的产品。在使用ROHM产品之前，请务必另行确认最新版的技术规格书或产品规格书。
- ROHM不保证本资料中的信息无误。万一客户或第三方因本资料中的信息错误而受损，ROHM不承担任何责任。
- 本资料中的应用电路示例等信息和各种数据仅为示例，并非保证不侵犯与这些内容相关的第三方的知识产权及其他权利。
- 对于本材料中的信息和各种数据，ROHM并未明示或默示同意客户可以实施、使用或利用ROHM或第三方拥有或管理的知识产权以及其他权利。
- 向海外出口或提供ROHM产品和本资料中的技术时，请遵守《外汇及外国贸易法》、《美国出口管制条例》等适用的出口相关法律法规，并根据这些法律法规中的规定办理必要的手续。
- 未经ROHM事先书面同意，严禁转载或复制本资料的全部或部分内容。
- 本资料中的内容为截至2023年8月的信息，如有更改，恕不另行通知。



罗姆半导体集团

日本京都市右京区西院沟崎町21号
邮编：615-8585

www.rohm.com.cn